

『第47回ネプコン ジャパン』出展のお知らせ

当社は、2018年1月17日～19日に開催されます『第47回ネプコン ジャパン』に出展することになりましたので、その概要を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 展示会の概要

名 称： 第47回ネプコン ジャパン
開催期間： 2018年1月17日～19日
場 所： 東京ビッグサイト
公式サイト： <http://www.nepconjapan.jp/>

2. 出展の内容

以下の製品を中心に、ブースでのプレゼンテーション及びパネルでの展示を行います。

- (1) 高速・高精度に6面検査が可能なパワーデバイス用チップ向け外観検査装置「CI4000」
- (2) セラミック基板や焼成前のグリーンシート状態での金属ペースト検査が可能な各種基板向け外観検査装置「FVシリーズ」



CI4000



FVシリーズ

- (3) 半導体パッケージをはじめ各種電子部品用外観検査ユニットとして好評の2次元（2D）／3次元（3D）検査ユニット
（3D検査手法による立体欠陥の検出や、照明条件により変化する様々な検査画像を用いた欠陥検査について、実際に体感いただきます。）

3. お問い合わせ先

<本お知らせに関して>

株式会社安永 管理本部 経営企画部 蔵本、藤原
(TEL: 0595-24-2122)

<製品、技術に関して>

株式会社安永 CE事業部 マーケティング部 営業2グループ 松井
(TEL: 0595-24-2252)

以 上